## AROMATIC POLYESTER-AMIDE AND ITS PRODUCTION

Patent number:

JP60206828

**Publication date:** 

1985-10-18

Inventor:

OBARA TEIJI; OOBA MASAYUKI; SANADA SHINICHI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

C08G69/44

- european:

Application number: JP19840061207 19840330 Priority number(s): JP19840061207 19840330

Report a data error here

#### Abstract of JP60206828

PURPOSE:To obtain the titled amide excellent in heat resistance, mechanical strength, electrical insulation, moldability and compatibility with other resins, by polycondensing monomers in the presence of a specified MW modifier. CONSTITUTION:Terephthaloyl dichloride and/of isophthaloyl dichloride (A) are reacted with (B) 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)propane and 2,2-(4'-hydroxy-4"-aminodiphenyl)propane and (C) 0.2-3 equivalent %, based on component A, aromatic monohydroxy compound (e.g., p-hydroxydiphenyl) as a MW modifier at 0-30 deg.C in the presence of an acid acceptor (e.g., triethylamine) in an inert organic solvent (e.g., tetrahydrofuran) to obtain the titled amide containing structural units of formulae I -IV (wherein the structural units are bonded to each other through an ester and/or amide bond), terminated with an aryloxy group (e.g., monovalent group derived by removing the hydroxylic H atom from a phenol derivative) and having a logarithmic viscosity of 0.4-1.0dl/g.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ② 公開特許公報(A) 昭60-206828

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

**43公開 昭和60年(1985)10月18日** 

C 08 G 69/44

7142-4J

審査請求 未請求 発明の数 2 (全9頁)

芳香族ポリエステルアミド及びその製造方法 の発明の名称

> 願 昭59-61207 創特

@出 願 昭59(1984)3月30日

60発明者 小 原 禎 二

川崎市幸区小向東芝町1番地 東京芝浦電気株式会社総合

@発明者 大 場 正

川崎市幸区小向東芝町1番地 東京芝浦電気株式会社総合

研究所内

砂発 明 者 真田 信

川崎市幸区小向東芝町1番地 東京芝浦電気株式会社総合

研究所内

勿出 顋 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 津 国 四代 理

1. 発明の名称

芳香族ポリエステルアミド及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

1.式(1),(1),(11);(11);

で示される構造単位を含み、各構造単位がエステ ル結合及び/又はアミド結合により連結され、か つ末端がアリールオキシ基を有し、 0.4~ 1.0 dl/g (シクロヘキサノン中、30℃で測定)の 対数粘度を有する芳香族ポリエステルアミド。 2. アリールオキシ基が、式〔V〕:

$$-0 \xrightarrow{R_1} \xrightarrow{R_2} x \xrightarrow{R_4} \xrightarrow{R_5}$$

(式中、Ri~Riは、それぞれ、同一であって も異なっていてもよく、水素原子、フェニル基、 炭素原子数1~4·0アルキル基又は炭素原子数1 ~4のアルコキシ基を衷わし、Xは直接結合、メ チレン基又は2.2-プロピレン基を衷わし、 n は O 又は1である)

で示される基である特許構求の範囲第1項に記載 の芳香族ポリエステルアミド。

3. 式(1), (11), (11) 及び(17):

特開昭60-206828(2)

$$-\frac{c}{0} - \frac{c}{0} - \frac{c}{0} - \frac{c}{0}$$

$$-0 \leftarrow \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \begin{array}{c$$

で示される構造単位を含み、各構造単位がエステル結合及び/又はアミド結合により連結され、かつ末端がアリールオキシ基を有し、 0.4~ 1.0 dl/g (シクロヘキサノン中、 3 0 ℃で測定) の対数粘度を有する芳香族ポリエステルアミドの製造方法であって、

テレフタル酸ジクロリド及び/又はイソフタル酸 ジクロリドと、 2 、 2 ーピス (4′ ーヒドロキシ フェニル)プロパン及び 2. 2- (4'-ヒドロキシー4'-アミノジフェニル)プロパンとを分子量關節剤である芳香族モノヒドロキシ化合物と共に重縮合させることを特徴とする芳香族ポリエステルアミドの製造方法。

4. アリールオキシ基が、式 (V):

(式中、R1~R6は、それぞれ、同一であっても異なっていてもよく、水素原子、フェニル基、炭素原子数1~4のアルキル基又は炭素原子数1~4のアルコキシ基を表わし、Xは直接結合、メチレン基又は2,2-プロピレン基を表わし、nは0又は1である)

で示される基である特許研求の範囲第3項記載の 製造方法。

3. 発明の詳細な説明

#### (発明の技術分野)

本発明は芳香族ポリエステルアミド及びその製造方法に関し、更に詳しくは、高い耐熱性、高い 機械的強度及び良好な電気絶縁性等を保持し、し かも、成形性が優れた芳香族ポリエステルアミド 及びその製造方法に関する。

# (発明の技術的背景とその問題点)

近年、高分子化学工業の進展に伴い、耐熱性、 機械的強度及び電気絶縁性等が優れた芳香族ポリ エステルアミドが開発されて来ているが、電気・ 電子分野において要求される高性機樹脂として、 十分満足できるものは得られていないのが現状で ある。

目的とする高性能樹脂を得るために、研究・開発が進められた結果、特別昭 5 7 - 1 0 8 1 2 9 号公報、特別昭 5 7 - 1 0 8 1 3 0 号公報、特別昭 5 7 - 1 0 8 1 3 1 号公報、特別昭 5 7 - 1 0 8 1 3 1 号公報、特別昭 56 - 1 5 7 4 2 3 号公報、特公昭 4 6 - 3 7 7 3 9 号公報、ジャーナル・オブ・ポリマー・サイエンス:ポリマー・ケミストリー・エデション、第 2 0 巻、

6 8 3 頁、 1 9 8 2 年( Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition, <u>2 0</u>, 6 8 3 (1 9 8 2))等において種々の方法が提案されている。

これらの先行技術文献には、溶液 宜合法又は界面重合法を適用して、テレフタル酸もしくはイソフタル酸又はこれらの誘導体(A)と、2.2-(4'-ヒドロキシ-4"-アミノジフェニル)プロパン又はその誘導体(B)より芳香族ポリエステルアミドを製造する方法が開示されている。

溶液置合法は前記した(A)及び(B)の原料を非反応性有機溶剤中、第3級アミン等の酸受容剤の存在下に反応せしめる方法である。また、界面重合法は前記した(A)の原料を含む非反応性有機溶剤溶液と前記した(B)の原料を含むアルカリ水溶液を混合して反応せしめる方法である。

これらの方法により得られる芳香族ポリエステルアミドは、例えば耐熱性が良好である (例えば、ガラス転位温度:220で以上) 反面、成形温度が高いため成形性が低下するという欠点があった。

特開昭60-206828 (3)

したがって耐熱性、機械的強度、電気絡縁性及び 成形性等の種々の特性をパランス良く具備した芳 香族ポリエステルアミドの製造方法の出現が望ま れていた。

(発明の目的)

<u>;</u> •

本発明の目的は上記した従来の芳香族ポリエステルアミド及びその製造方法の欠点の解消にあり、耐熱性、機械的強度及び電気絶縁性等を損なうことなく、しかも成形性に優れた芳香族ポリエステルアミド及びその製造方法を提供することにある。 (発明の概要)

本発明の芳香族ポリエステルアミドは、

式 (1), (11), (11)及び (17):

$$-0 \leftarrow C + \frac{C}{C} + \frac{N}{N} + \frac{N}{$$

で示される構造単位を含み、各構造単位がエステル結合及び/又はアミド結合により連結され、かつ末端がアリールオキシ基を有し、 0.4~ 1.0 dl/g (シクロヘキサノン中、 30℃で測定)の対数粘度を有するものである。

本発明の芳香族ポリエステルアミドは平均重合 度が60~300の範囲であり、好ましくは90 ~250の範囲である。また、重量平均分子量は 2×10<sup>4</sup>~1×10<sup>5</sup> の範囲であり、好ましく は3×10<sup>4</sup> ~ 8×10<sup>4</sup> の範囲である。さらに また、対数粘度が 0.4~1.0 dl/g の範囲であり、 好ましくは0.5 ~0.9dl /s の範囲である。対数 粘度が 0.4dl/g 未満の場合には、ガラス転位温 度が低下するとともに、機械的強度も低下し、1.0 dl/g を超える場合は、溶融粘度が高すぎ成形性 が不良となる傾向があるため、好ましくない。な お、本発明は使用する原料の組成及び製造方法に より、又、反応原料である化合物の反応性の相違 により、種々の構造を包含することが可能であり、 例えば、交互共重合体、プロック共量合体、ラン ダム共重合体又はこれら重合体の組合せ等が挙げ

本発明はその特定の構造に対応して、各種の溶剤に可溶であり、軟化温度が向上し、400℃以上の高い分解温度を有する。また、他の樹脂との

1966年 1971 1985年 1月24日 1月24日 1月26日 1月27日 1月28日 1月18日 1月28日 1月18日 1月18日

相溶性並びに各種充塡剤との混和性が優れ、成形加工が極めて容易であるという特徴を有する。しかして、本発明はこのような性質を活用してワニス化、溶液からのキャスティングによるフィルム化、溶液または溶解物として押出成型、射出成型、比縮成型、繊維化、製紙化又はジート化等の加工を施して、電気絶縁材料、電子部品成型材料、耐熱接着剤又は強料等の窒素上幅広い用途を有するものである。

例えば、本発明の化合物の一つである次式の構造を有する芳香族ポリエステルアミド (実施例 1 で得た) は、

(式中、
$$Y^1$$
、 $Y^2$ 、 $Y^3$ 及び $Y^4$ は $-0$ - 甚又は $-NH$ - 甚を衷わし、 $Y^1$  と $Y^2$  は及び/又は $Y^3$  と $Y^4$  が同時に $-NH$ - 甚であることはなく、nは約130である。)

重量平均分子量が 4.8×10<sup>14</sup> (平均重合度 約130)であり、ガラス転位温度が221℃、船天秤により測定した5%重量減少温度が435℃であった。また、対数粘度は0.63d1/g であった。ついで、得られた重合物を加圧成形機により、280℃、200㎏/cdに圧縮成形して試作版を得た。この試作板は、そり、歪み、フィッシュアイ、色むら等の異常のない良好な成形物であった。

本発明の芳香族ポリエステルアミドの製造方法 は、

$$-0 \leftarrow \bigcup_{C} \bigcup_{H} \bigcup_{3} NH - (N)$$

で示される構造単位を含み、各構造単位がエステル結合及び/又はアミド結合により連結され、かつ未端がアリールオキン基を有し、 0.4~ 1.0 dl/g (シクロヘキサノン中、30℃で測定)の対数粘度を有する芳香族ポリエステルアミドの製造方法であって、

テレフタル酸ジクロリド及び/又はイソフタル酸ジクロリドと、2.2-ピス(4'ーヒドロキシフェニル)プロパン及び2.2-(4'ーヒドロキシ-4'ーアミノジフェニル)プロパンとを分子量関節剤である芳香族モノヒドロキシ化合物と共に重縮合させることを特徴とするものである。

本発明に使用される分子量偶節剤は 2.2-ビス (4'-ヒドロキシフェニル) プロパンと同程度の 反応性を有する化合物であれば格別限定されない。 この分子量調節剤として好ましくは芳香族モノヒ ドロキシ化合物であり、例えばフェノール、 o ークレゾール、 m ークレゾール、 p ークレゾール、 2.5-キシレノール、 2.6-キシレノール、 3.4-キシレノール、 3.5-キシレノール、 3.5-トリメチルフェノール、 2.3.5-トリメチルフェノール、 2.4.6-トリメチルフェノール、 o ーメトキシフェノール、 m ーメトキシフェノール、 m ーフェニルフェノール、 m ーフェニルフェノール、 p ーペンジルフェノール、 2 ーフェニルフェノール が が が c o れる。

この分子量調節剤の使用量は、目的とする芳香 族ポリエステルアミドの所望の分子量に応じて異 なるが、テレフタル酸ジクロリド及び/又はイソ フタル酸ジクロリドの合計した当量に対し、通常、 0.2~3 当量%の範囲であり、好ましくは 0.4~ 2.5 当量%の範囲である。この 0.2当量%未満の 場合は、 頭合体の分子量が大きくなりすぎ、 3 当 置%を超える場合には分子量が小さくなりすぎる ため望ましくない。

本発明の芳香族ポリエステルアミドは重縮合反応によって行われるものであり、通常、溶液重合法又は界面重合法を適用して行われる。

原料、分子量調節剤及び酸受容剤を使用して、 反応系を形成する順序及び方法は格別限定されない。この具体例としては、原料B、分子量調節剤 及び酸受容剤から成る溶液に原料Aの溶液を徐々 に添加する方法、又は原料Aの溶液に原料B、分 子量調節剤及び酸受容剤から成る溶液を添加する 方法等が挙げられる。

非反応性有機溶剤中の原料及び分子量調節剤の 濃度は、合計量で、通常、2~25 量量%の範囲、 好ましくは5~20 量量%の範囲である。酸受容 剤の使用量は、通常、原料Aの合計当量に対し、 100~110当量%の範囲、好ましくは生成す る酸に対して化学量論量もしくはそれ以上である。

反応温度は、通常、0~30℃の範囲、好ましくは10~25℃の範囲であり、反応時間は、通常、1~20時間の範囲、好ましくは2~10時間である。

つぎに、界面重合法においては、原料 A 及び非 反応性有機溶剤の溶液と、原料 B 及び分子量調節 剤のアルカリ水溶液とを混合して重合反応を進め

る。

原料及び分子量調節剤の使用量は、原料Aの合計当量に対して原料Bおよび分子量調節剤の範囲を設定を対して原料Bおよび分子量調量剤の範囲、好まして原料Bである。有機溶剤は芳香を混れて、通常のであり、この具体例としてエチレンをであり、この具体例としてエチリウム、サークローン等が挙げられる。のは、水酸化カリウム等が挙げられる。

原料及び分子量調節剤を使用して、反応系を形成する順序及び方法は格別限定されない。この具体例としては、原料Bおよび分子量調節剤を溶解したアルカリ水溶液に、原料Aを溶解せしめた有機溶剤溶液を、激しく攪拌下、一度に添加・混和して反応せしめる方法等があげられる。

有機溶剤中の原料Aの濃度は、通常、2~25 重畳%の範囲、好ましくは5~20重量%の範囲 である。アルカリ水溶液中の原料B及び分子量調節剤の濃度は、通常、2~25重量%の範囲、好ましくは5~20重量%の範囲である。アルカリの使用量は、通常、原料Aの合計当量に対し100~110 当量%の範囲、好ましくは生成する酸に対して化学量論量もしくはそれ以上である。

反応温度は、通常、0~30℃の範囲、好ましくは10~20℃の範囲であり、反応時間は、通常、0.1~2時間の範囲、好ましくは1時間前後である。

なお、界面重合法においては、 重合反応を円滑 に連行させるため、必要に応じて分散剤を使用し てもよい。この分散剤の具体例としては、ラウリ ル硫酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸 ナトリウム、セチルトリメチルアンモニウムクロ リド、セチルピリジニウムクロリド、トリメチル ベンジルアンモニウムクロリド等が挙げられる。

前記した溶液重合反応及び界面重合反応の後処理は、公知の方法を適用して、生成した芳香族ポリエステルアミドを単離すればよい。この方法の

具体例としては、反応混合物もしくは反応溶液を、 メタノール、エタトル、トルエン及びアセトン等 の芳香族ポリエステルアミドの非溶剤中に注ぎポ リマーを沈澱せしめる方法等が挙げられる。

本発明の製造方法に係る芳香族ポリエステルアミドは、対数粘度が 0.4~1.0 dl/g の範囲、好ましくは 0.5~0.9 dl/g の範囲のものである。なお、この対数粘度はポリマーの濃度 0.5 g/dlのシクロヘキサノン溶液の 3 0 でにおける粘度をウベローデ型粘度計を使用して測定したものであって、対数粘度は次式で求めた。

本発明の製造方法に係る芳香族ポリエステルア ミドは伯種のポリマーや無機質の充塡剤や繊維な どを混合し、その成形性、耐熱性、機械的強度等 の性質を改良することもできる。更に、成形物の 耐熱性、耐光性、耐酸化性、耐候性などを改良す るために安定剤として紫外線吸収剤、例えば、 a -オキシベンゾフェノン誘導体、サリチル酸エ ステル、ベンゾトリアゾール誘導体等、あるいは 酸化防止剤、例えばフェノール誘導体、ホスフア イト系化合物等、を添加することもできる。また、 ポリマーの成形加工性や機械的特性を改良する目 的で可塑剤あるいは熔融粘度調節剤、例えば、フ タル酸エステル、リン酸エステル等、を添加する こともできる。更に、難燃性や消炎性を付与する ために酸化アンチモンあるいはホスフェート化合 物などを配合することもできる。

# (発明の効果)

以上に辞述した通り、本発明の芳香族ポリエス テルアミドは高い耐熱性、高い機械的強度及び良 好な電気絶疑性等を保持し、しかも成形性が優れ #リマー溶液の流れ時間 溶剤のみの流れ時間 ポリマー濃度

(式中、ポリマー濃度の単位は g/diである)

本発明の製造方法に係る芳香族ポリエステルア ミドは、耐熱性等の趨特性が優れているため、高 性能エンジニアリング・プラスチックス等の様々 な用途に応用され得る。また、この成形品は粉末、 チップもしくはペレット状のものに、圧縮成形、 熔融押出し成形、トランスファー成形、射出成形 等の各種の方法を適用して作成され得る。

E編成形法では、ポリマーの溶融点以下、ガラス転位点以上の温度で成形することが選ましく、 通常、その温度は200~300で実施するの が有利である。熔融押出し法、トランスファー成 形法又は射出成形法などでは、熔融ポリマーの流 れ性と熱分解を考慮して、通常、260~360 での温度で実施するのが有利である。

ているため、その耐熱性樹脂としての工業的価値 は極めて大である。

### (発明の実施例)

以下、本発明の実施例及び比較例を掲げ、更に詳細に説明する。なお、実施例及び比較例中、「部」はすべて「重量部」を示す。重合反応は全て審業雰囲気下で行った。また、ガラス転位温度は示差走査熱量分析(DSC)により測定し、曲げ強度及び曲げ弾性率はASTM D-790の測定法に従った。

# 実施例1

2,2-ビス (4'-ヒドロキシフェニル) プロパン 114.8部、2,2-ビス (4'-ヒドロキシー 4"-ア 1,14.8部、2,2-ビス (4'-ヒドロキシー 4"-ア 1,20つまニル4.71部にテトラヒドロフラン1200部とトリエチルアミン 214部を加えて溶解した。この溶液を20~25でに保ちつつ環律しながら、テレフタル酸ジクロリド 101.5部とイソフタル酸ジクロリド 101.9部をテトラヒドロフラン 500部に溶解した溶液を15分間にわたって徐々に加え、

その後20~25 ℃にて8時間反応を行わせた。 反応終了後、反応混合物をメタノール 20000部中 に投入してポリマーを析出せしめ、ポリマーを単 雕した。このポリマーを再度テトラヒドロフラン 2300部に溶解し、メタノール 20000部中に投入し て再沈殺し、ポリマーを精製した。得られた芳香 族ポリエステルアミドの収量は 346部(収率 9 6 %)であった。

得られた芳香族ポリエステルアミドの対数粘度は0.63d1/g であった。本実施例では、pーヒドロキシジフェニルの添加量は、ポリマーの対数粘度が0.65d1/g となるように予定し使用したものである。このポリマーを加圧成形機により、温度280で、圧力200kg/cdにて圧縮成形し直径100mx、厚さ0.5~6mmの板を試作した。得られた試作板は淡黄色透明で、異状形態の成形物はできず、機械的にも強靱なものであった。

#### <u> 実施例2~6</u>

分子量調節剤としてフェノール、m-クレゾール、p-ヒドロキンジフェニル、p-ベンジルフ

# ェノールを使用して、実施例1と間様にして芳香 族ポリエステルアミドを製造した。反応条件、ポ リマー収率及び対数粘度を衷1に示す。

#### 比較例1

分子量調節剤の芳香族モノヒドロキシ化合物を使用しない以外は実施例1と同様にして重合を行った。即5、2.2-ピス(4'ーヒドロキシフェニル)プロパン 57.53部、2.2-ピス(4'ーヒドロキシー4\*ーアミノジフェニル)プロパン 56.37部、テレフタル酸ジクロリド 50.45部及びイソフタル酸ジクロリド 51.06部をテトラヒドロフラン1100部中でトリエチルアミン 105部の存在下に反応せしめ芳香族ポリエステルアミド 174部(収率 9 7 %)を得た。

得られた芳香族ポリエステルアミドの対数粘度は1.29d1/g であった。このポリマーを実施例1と同じ条件で圧縮成形したところ、厚さの輝い(0.5~3 m) 試作板の形状は比較的良好であったが、厚さの厚い(4~6 m) 試作板はそりが生じた。

#### 比較例 2

分子量個節剤としてp-ヒドロキシジフェニルを多く使用する以外は、実施例1と同様にして置合を行った。即ち、2,2-ビス(4'ーヒドロキシフェニル)プロパン 57.41郎、2,2-ビス(4'ーヒドロキシー 4\*-アミノジフェニル)プロパン54.32郎、p-ヒドロキシジフェニル3.58部、テレフタル酸ジクロリド 50.96部をテトラヒドロフラン 850部中でトリエチルアミン 106部の存在下に反応せしめ芳香族ポリエステルアミド 175部(収率 9 7 %)を得た。

得られた芳香族ポリエステルアミドの対数粘度は0.38d1/g であった。このポリマーを温度 250 で、圧力 1 0 0 kg/cdにて圧縮成形し実施例 1 と同様な板を試作したが機械的強度は晩かった。

なお、実施例1~6および比較例1および2で 得られた芳香族ポリエステルアミドのガラス転位 温度、成形物の曲げ強度および曲げ弾性率、成形 物の外観を表2に示す。

# 実施例7

これに対し、比較例1の芳香族ポリエステルア ミドでは、溶融粘度が5×10<sup>5</sup>poise以上 に達し、流れ性に乏しかった。また、比較例2の 芳香族ポリエステルアミドは、溶融粘度が3.6× 10<sup>3</sup>poiseと小さく流れ性にすぐれていた が、溶融粘度押出成形物は、機械的強度が脆かった。

# 比較例 3

分子量調節剤を使用すると、2,2 ーピス(4'ーヒドロキシフェニル)プロパン及び2,2 ー(4'ーヒドロキシー4"ーアミノジフェニル)プロパンの合計のモル数と、テレフタル酸ジクロリド及びイソフタル酸ジクロリドの合計のモル数との比を0.98:1.00とする以外は実施例1と同様にて銀合を行ない、対数粘度0.51d1/8 の芳香族

marking the state of

ポリエステルアミド (収率; 93%) を得た。 実施例8

比較例1及び比較例3で得た芳香族ポリエステルアミドを各々1、4ージオキサンに溶解し、キャスティング法により30µ厚のフィルムを作成した。これら2様のフィルムを210℃、空気中で120時間加熱したのち、各々の芳香族ポリエステルアミドの対数粘度を測定した。実施例1の芳香族ポリエステルアミドのフィルムでは0.61d1/8で、対数粘度の保持率は97%で、分子量の変化はわずかであった。これに対し、比較例3の芳香族ポリエステルアミドのフィルムでは0.42d1/8で、対数粘度の保持率は82%で分子量の低下がみられた。

表---1

実施例	テレフタル酸 ジクロリド	イソフタル酸 ジクロリド	ヒドロキシフェ	ロキシー 4 ー	芳香族モノヒド ロキシ化合物	酸受容剂	溶剂	反応温度	反応時間	ポリマー 収率	刘毅相度
	部	部	部	ル) プロパン 部	部	部	·##	E	時間.	%	dl/g
2	51.26	51.67	58.22	56.12	フェノール 0.96	トリエチルア ミン 107	テトラヒド ロフラン 850	20~25	8	9 7	0.68
3	50.96	50.98	57.30	55.91	m-クレゾール 1.14	トリエチルア ミン 108	クロロホル ム 850	20~25	5	97	0.66
4	50.75	51.16	57.30	54.89	pーヒドロキシ ジフェニル 3.17	トリエチルア ミン 107	テトラヒド ロフラン 850	20~25	8	9 6	0.51
5	50.75	51.37	57.64	56.14	p-ヒドロキシ ジフェニル 1.14	トリエチルア ミン 108	テトラヒド ロフラン 1,000	20~25	8	98	0.82
6	51.16	51.37	58.33	55.33	p - ベンジル フェノール 2.32	トリエチルア ミン 108	塩化メチレ ン 850	20~25	5	97	0.65

in work on the least well interest the least a country of

表 2

芳香族ポリ テルアミト		ガラス転位 温度 で	曲げ強度 kg/m m	曲げ 弾性率 kg/m n	外観
実施例	1	2 2 3	11.2	2 4 1	異常なし
実施例	2	2 2 6	11.1	242	"
実施例	3	2 2 5	11.3	241	<b>"</b>
実施例	4	217	11.3	240	~
実施例	5	227	11.0	238	~
実施例	6	2 2 5	11.3	240	
比較例	1	2 2 9	10.9	238	そり 発生
比較例	2	182	脆い	脆い	異常なし